반도체장학사업 소개 자료

- 인적자원개발팀 -



사업개요

- 이공계 기피현상으로 침체되어 있는 반도체관련 학과의 인재양성개발을 지원함으로써 반도체산업의 중요성 및 지속적인 발전전략 마련 필요성에 대한 공감대 형성
- 미래선도산업으로 차세대반도체산업의 융복합 기술을 갖춘 우수한 잠재인력 지원 및
 양성을 통해 국가 산업 발전에 기여

사업목적

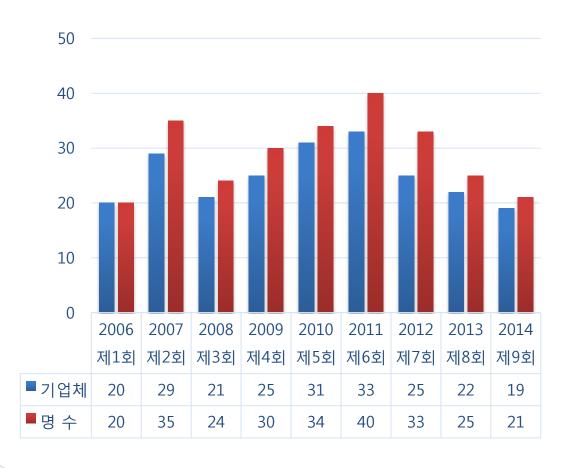
● 반도체관련 학과의 인재양성 지원을 통해 반도체산업 및 기업 이미지 제고

사업연혁

- 반도체협회 장학사업 추진 필요성 제기: 2006. 3. 15
- ◎ 장학사업 추진에 대한 이사회 의결: 2006. 5. 7

추진실적

◎ 지난 9년 간 총 59개사에서 262명의 장학생에게 장학금 지원



<'14년 9회 반도체장학사업 참여 기업>

SK하이닉스	에이에스엠엘코리아								
국제엘렉트릭코리아	에프에스티								
도쿄일렉트론코리아	엑시콘								
동부하이텍	원익IPS								
동진쎄미켐	원익머트리얼즈								
램리서치코리아	이오테크닉스								
삼성전자	케이씨텍								
세메스	피에스케이								
실리콘마이터스	피케이엘								
어플라이드머트리얼즈코리아									

2015년 추진계획

<추진 일정(안)>

세부 일정 3	6	월	7월			8월				9월				10월				H D	
	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	비고
참여 희망 기업 수요 조사	—		\rightarrow																전 회원사
장학생 추천 접수 및 기업별 면접			→											\rightarrow					기업별 면접 진행
장학생 선발												+					\rightarrow		
장학기금 출연 요청																			
장학증서 수여																		+	10/29(목)

<장학생 선발 및 지급 절차>

장학사업 참여희망 업체 수요조사 (참여 의향서 접수)

(6/19~7/10)

주요 대학 장학생 추천 의뢰 및 접수

 $(7/1 \sim 9/30)$

장학생 선발 (각 기업별 면접실시)

 $(7/7 \sim 10/2)$

제 10회 반도체장학생 최종 선발 및 공고

(10/2~10/17)

기업별 장학금 출연 (1계좌/1,000만

원)

(9/10~10/17)

장학금 수여 (반도체의 날부대행 사)

(10/29)

장학생 자격

- 향후 차세대반도체산업을 이끌어갈 우수인재로서, 차년도 대학4학년 또는 대학원 2년차 진학예정자로 반도체관련분야 이공계 학생
- 동일 학기 중에 타 장학금을 중복하여 받지 않고 있는 학생

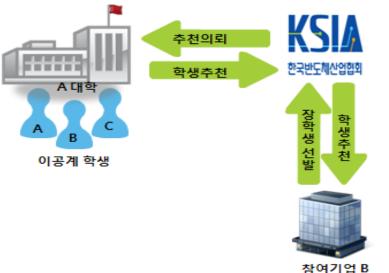
장학생 선발 방법

① 기업 자체 선정

이공계 학생



② 협회 추천 선정(단,기업이 특정 대학(과)지정)



장학금 지원 및 지급방법

- 장학금 지원 금액: 1인당 1,000만원참고) 동 사업은 업체당 1계좌 이상씩 출연하여 이공계 대학(원)생을 선발, 지원하는 방법으로 추진
- 해당 대학으로 장학금이 입금 완료되면, <u>기부금영수증 발급</u> (대학 ⇔ 기업)
- 명칭을 '반도체장학금'으로 통칭하되, Sub Title로는 기탁자 명의의 장학금으로 지급할 예정 예시) 삼성전자 장학급, 원익 장학급, 세메스 장학급, 미코 장학금 등

제 10회 반도체장학증서 수여식

- 일시/장소: 2015. 10. 29(목) 16:30~ / 코엑스 인터컨티넨탈 비바체 및 하모니블룸 (예정)

- 프로그램: 장학생-참가기업 대면식, 반도체장학금 수여식

- 참 석 자 : 참가기업 대표이사 또는 인사담당자, 장학생 등 80여명







- 장학사업 문의: 인적자원개발팀 이민지 주임 (02-570-5218 / milee@ksia.or.kr)